U3-3276LE-C-HQ Rev.1.2 (AB03454)

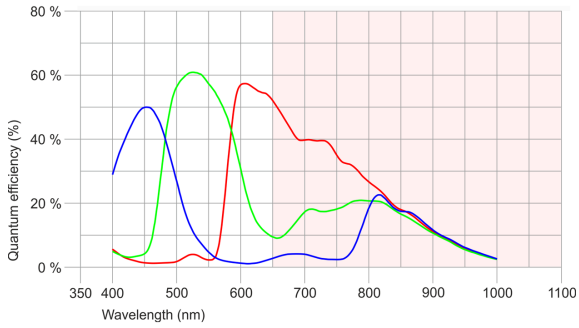
■ 量産中
このカメラモデルは量産中で長期にわたりご使用いただけます。



仕様

センサー

センサーのタイプ	CMOS カラー
シャッター	グローバルシャッター
特性	リニア
解像度/ピクセル	3 MP
有効画素数	3.19 メガピクセル
有効画素数 (h x v)	2064 x 1544 ピクセル
アスペクト比	4:3
ADC	12 bit
色深度 (カメラ)	12 bit
光学センサークラス	1/1.8''
撮像面積	7.093 mm x 5.320 mm
光学センサーの対角	8.87 mm 1/1.8"
画素サイズ	3.45 µm
CRA (主光線角)	0 °
メーカー	Sony
センサーモデル	IMX265LQR-C
ゲイン (マスター/RGB)	25.4x/16x
AOI 水平	同じフレームレート
AOI 垂直	増加したフレームレート
AOI 画像の幅、ステップ幅	256 / 2
AOI 画像の高さ、ステップ幅	2 / 2
AOI 位置グリッド (水平/垂直)	2 / 2
ビニング水平	-
ビニング垂直	-
ビニング手法	水平: - / 垂直: -
ビニング係数	-
デシメーション(サブサンプリング)水平	増加したフレームレート
デシメーション(サブサンプリング)垂直	増加したフレームレート
デシメーション(サブサンプリング)手法	M/C 自動



T.E.M. Incorporated
NBC Annex Ichigaya Bldg. 2F, 9-1 Funagawara-machi, Ichigaya, Shinjuku-ku · 162-0826 Tokyo, Japan · Telefon +81 3/5256-2054 · Fax +81 3/5256-2272 · E-Mail ids@tem-inc.co.jp

U3-3276LE-C-HQ Rev.1.2 (AB03454)

モデル

フレームレートフリーランモード	57 fps
フレームレートトリガー（連続）	59 fps
フレームレートトリガー（最大）	59 fps
露出時間（最小～最大）	0.024 ms – 2000 ms
長時間露出（最大）	90000 ms
消費電力	0.9 W – 1.9 W
画像メモリ	–

環境条件

下記の温度は、デバイス外部の温度を基準としています。

動作時の許容デバイス温度	0 ° C – 55 ° C / 32 ° F – 131 ° F
保管時の許容周囲温度	-20 ° C – 80 ° C / -4 ° F – 176 ° F
湿度（相対湿度、結露なし）	20 % – 80 %

コネクター

インターフェースコネクター	USB Type-C
I/O コネクター	–
電源	USB ケーブル

設計

レンズマウント	S-Mount
保護構造	IP30
外形寸法	47.0 mm x 46.0 mm x 25.0 mm
重量	37 g
ハウジング素材	プラスチック

Features

オンカメラ画像前処理機能のリスト。
このテーブルのすべての機能は、ホストコンピュータ上で画像の前処理を行うための IDS peak ソフトウェアを介して利用可能です（センサーのモデルによって異なります）。

画像取得	Freerun	✓
	Software trigger	✓
	Hardware trigger	–
	Trigger controlled exposure	–
	Denoiser	✓
	Long exposure	✓
	Line scan	–
フラッシュ	Flashing	✓
	PWM flashing	–
画像調整	Auto exposure	–
	Auto gain	–
	Auto whitebalance	–
	Color correction	–
	Gamma	–
	LUT	–
	Mirror/flip	X/Y

T.E.M. Incorporated
NBC Annex Ichigaya Bldg. 2F, 9-1 Funagawara-machi, Ichigaya, Shinjuku-ku · 162-0826 Tokyo, Japan · Telefon +81 3/5256-2054 · Fax +81 3/5256-2272 · E-Mail ids@tem-inc.co.jp

U3-3276LE-C-HQ Rev.1.2 (AB03454)

統合画像処理

Pixel formats	BayerRG8 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BayerRG10
Region of interest	✓
Decimation (FPGA)	✓
Decimation (Sensor)	2x2
Binning (FPGA)	–
Binning (Sensor)	

その他

Chunks	–
Sequencer	–
Events	–
Firmware update	✓
1st supported firmware version	2.20

T.E.M. Incorporated
NBC Annex Ichigaya Bldg. 2F, 9-1 Funagawara-machi, Ichigaya, Shinjuku-ku · 162-0826 Tokyo, Japan · Telefon +81 3/5256-2054 · Fax +81 3/5256-2272 · E-Mail ids@tem-inc.co.jp